

证券代码：688381

证券简称：帝奥微

## 江苏帝奥微电子股份有限公司 投资者关系活动登记表

2024年4月28日

<b>投资者关系 活动类别</b>	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
<b>参与单位名称</b>	百川财富、博时基金、常亿资产、丞毅投资、翀云私募、淳杨私募、大家资产、德邦证券、东兴基金、丰琰投资、福实管理、复胜资产、高信百诺、广发证券、贵源投资、国富产业投资、国海证券、国联证券、国盛证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、杭贵投资、泓澄投资、鸿运私募、华安证券、华创证券、华福证券、华杉瑞联基金、华泰证券、华西证券、汇丰前海证券、汇泉基金、惠通基金、精砚私募基金、九泰基金、宽源投资、龙全投资、美浓资产、弥远投资、民生证券、明世伙伴基金、摩根大通证券、摩根士丹利华鑫基金、盘京投资、平安银行、前海人寿保险、睿德信投资、睿融私募、润达私募、山西证券、善择私募、申银万国证券、盛钧私募基金、首创证券、太平基金、天玑投资、西部证券、西南证券、熙宁投资、橡果资产、新活力资本、鑫宇投资、信达证券、兴业基金、兴业证券、兴亿投资、亚太财产保险、野村东方国际证券、银润资产、英谊资产、誉辉资本、源闾投资、云杉投资、长城证券、招商信诺资产、招商证券、浙商证券、正圆私募、中国工商银行、中国人保资产、中金公司、中略投资、中泰证券、中信建投、中信证券、中邮人寿保险、中邮证券、中原证券等
<b>时 间</b>	2024年4月28日
<b>沟通方式</b>	线上沟通
<b>地 点</b>	公司会议室

<p>上市公司接待 人员姓名</p>	<p>董事长、总经理：鞠建宏 董事会秘书、副总经理：陈悦 财务总监：成晓鸣 销售市场部高级副总裁：鲁慧锋 证券事务代表：王建波</p>
<p>投资者关系活 动主要内容介 绍</p>	<p><b>1、请简单介绍公司年度和一季度情况？</b></p> <p>2023年，受宏观经济发展放缓影响，半导体市场整体面临较大压力，终端消费动力不足，行业及终端市场出现了去库存状况，市场竞争不断加剧，模拟芯片行业均受到影响。在此背景下，公司2023年实现营业收入3.8亿元，较上年同期下降23.96%；归母净利润1540万元，较上年同期下降91.14%；但公司23年有3300万元的股份支付费用，剔除掉股份支付费用影响后，公司归属于母公司所有者的净利润4,860万元，较上年同期下降73.87%。</p> <p>虽然受到宏观经济和整体行业影响，但公司仍积极应对，始终以市场为导向、以创新为驱动，重视公司研发方面的资金投入。2023年，公司研发费用为1.46亿元，较上年增长107.86%，占营业收入的比例为38.40%。公司产品型号也已达到1,600余款，产品类型逐渐丰富。</p> <p>2024年，公司全力拓展市场，提升客户份额，紧抓市场机遇，加大产品销售力度。一季度公司部分新产品已经开始向国内外头部客户出货。因此一季度公司营业收入1.28亿元，与上年同期相比，增长约70%，环比增长49.9%；实现归属于母公司所有者的净利润为1600万元，与上年同期相比，增长61%。扣非净利润实现扭亏为盈。公司仍坚持产品研发与创新，2024年一季度，公司研发投入合计3570万元，同比增长51.21%。</p> <p><b>2、公司汽车电子产品目前进展如何？</b></p> <p>公司的模拟开关、电源、运算放大器、马达驱动，车灯驱动，高边驱动，温感等多款产品已在多家终端汽车厂商、国际及国内头部Tier1</p>

实现量产。随着车规产品矩阵逐渐丰富，以及终端车厂客户群体的快速扩大，公司将在汽车电子领域迎来新的增长曲线。

### 3、公司在 AI 方面有哪些布局？

在 AI 终端产品方面，公司推出的 1.5A 超大电流，43mV 超低压差的多路 LDO 产品，可以有效降低 LDO 前级电源的供电电压，大大提高系统的电源效率，从而提升手机、运动相机、无人机等摄影设备在拍照和录像时的续航，目前已导入三星新款手机中。公司的高频小尺寸的 DCDC 转换器由于其高效、低纹波、可靠、节省空间等特性，已在知名终端电脑厂商的 AI 电脑产品中批量生产。

服务器领域，公司推出了全系列开关解决方案，包括具有 11GHz 高带宽的 PCIE3.0 开关、具有 Reset 功能或带中断输入的 8/4 通道的 I2C 开关等产品，以及一系列全新带  $\beta$  补偿的高精度 ( $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ) 1-4 通道温度传感器产品

### 4、公司 2024 年产品有什么规划？

公司将持续推进技术升级和产线拓展，沿着低功耗、大电流电源模块，高速接口，高性能运算放大器，高精度传感器，汽车智能照明驱动等方向进行拓展创新。随着研发人员的显著增加，公司产品正在往高复杂度、高集成度、高单价的方向布局，推动公司业绩的快速增长。

在高速接口方面，公司持续对现有高速 USB 模拟开关进行升级和拓展，布局超高速 USB4.0 模拟开关，进一步巩固公司在移动通讯市场的 USB 接口芯片的主流市场地位，力争打造国内甚至亚洲 USB 接口最完整的产品线。

在高精度产品方面，公司不断升级现有高精度运算放大器的产品系列，扩展高压高精度产品系列，从 75V 以下产品扩充到 110V 高精度运放；从电流检测、温度检测方向扩充到功率检测。同时开发低功耗高

精度温度、湿度霍尔传感产品，进一步拓展高速高精度信号链模拟芯片在服务器/数据中心和汽车传感器市场份额。

在高功率密度产品方面，公司将继续沿着低功耗，超小尺寸封装等方向继续深耕。同时围绕高效小型化的理念将产品拓展至 OLED 电源，摄像头新一代 PMIC，光模块特色电源等多个应用领域。高边开关产品保持现有产品尺寸的同时将朝更大电流更低阻抗方向布局。实现公司产品逐渐小型化、低功耗化发展。

数模混合方面，公司已经组建完成了一支功能齐备的数字设计团队，为公司的数模转换产品提供技术支持。在汽车车灯驱动产品规划中，公司的氛围灯将集成 MCU 的同时提供光学算法，马达驱动产品，将扩展到集成 MCU 的步进及三相无刷电机控制 SOC 芯片产品。同时，公司将联合头部车企布局适用于功能安全系统的 SBC 产品，该产品将集成多路电源及通讯接口。在 AI 服务器领域，公司也在针对最新一代的 INTEL 平台开发创新的 I3C 通讯接口类产品。